

## 加入线上会议 和奥特斯一起探讨最前沿的计算技术

上海2024年2月29日 /美通社/ -- 2024年3月20日，全球微电子行业的领军企业奥特斯将举办一场别开生面的线上研讨会，在数字技术发展的关键时刻为大家解读未来的计算技术。奥特斯业务开发经理洪昱宇（Carrey Hong）将以“实现微型化、标准化和高性能的SiP系统级封装”为主题，讲解微芯片封装领域的技术突破，并分析当前的市场趋势。会议现已开放在线注册。

人工智能或高速通信网络等新发展有望彻底改变我们在数字领域的生活和工作方式。但促进未来突破所需的功能强大、效率高的微芯片的开发已接近基本极限，如果我们无法通过晶体管的微型化来提高微芯片的性能和能效，我们就必须寻找其他的改进方法。最前沿的概念之一就是高效封装，将多个高度专业化的微芯片互连成为强大而高效的SiP模组。

奥特斯是全球领先的高密度互连和高度微型化半导体封装载板企业，这种载板可将多个不同性能的芯片封装成强大的计算单元，足以支撑数字革命。在题为“实现微型化、标准化和高性能的SiP系统级封装”的在线研讨会上，奥特斯业务开发经理洪昱宇将详细解释如何通过先进的载板技术实现微型化，标准化的SiP模组，以及为什么它能成为未来的方向之一。

奥特斯诚邀对数字技术、芯片或人工智能感兴趣的决策者和技术爱好者参与2024年3月20日的网络研讨会。本次活动将于9:00现场直播，并提供录播，以供会后查阅。如需参与直播，请登录 <https://eventmaker.at/ats/sip-webinar/press.html>进行在线注册。议程包括演讲和问答两大环节。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/207453.html>